



## リジット基板・フレキシブル基板 無電解 Ni-Pd-Au めっき

### ～特徴～

無電解 Ni-Au 厚付けめっき製品の代替皮膜としてリジット基板・FPC 等の製品に処理が可能です。

半田付け性、ボンディング性は電解ボンディング (軟質) Au めっきと同等レベルを実現しております。

無電解 Ni-Au 厚付けめっきの VE をご検討の場合は是非ともご検討下さい。

### ～生産能力～

#### ◎対応製品サイズ

サイズ (MAX) 510×610mm 約 6,000 m<sup>2</sup>/Month

#### ◎対応めっき仕様

無電解 Ni めっき 0.25～7.00  $\mu$ m (P 濃度 6.0±1.0%)

無電解 Pd めっき 0.025～0.20  $\mu$ m (Pd-P 濃度 7.0±1.0%)

無電解 Au めっき 0.05～0.20  $\mu$ m

◆ファインパターン対応の無電解 Ni-P 浴

◆膜厚均一性に優れています。

◇無電解 Ni-Pd-Au めっき浴は汚染に非常に弱く、量産前に溶出テスト等の実施をお勧めしております。